

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2026-001

沪士电子股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2026年1月6日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第十二次会议（临时会议）通知。会议于2026年1月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，其中陈梅芳女士、吴传林先生、官锦堃先生、高启全先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于同意签署投资合作协议暨对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为落实公司战略发展规划，推动前沿技术研发与产业化布局，经公司董事会战略与ESG委员会提议，同意开展“高密度光电集成线路板项目”（下称“本项目”）。本项目计划在常州市金坛区投资设立全资子公司，搭建CoWoP等前沿技术与mSAP等先进工艺的孵化平台，构建“研发-中试-验证-应用”的闭环体系，布局光铜融合等下一代技术方向，系统提升产品的信号传输、电源分配及功能集成能力，待相关技术工艺验证成熟并具备产业化条件后，投建高密度光电集成线路板的规模化生产线。计划设立的全资子公司注册资本为1亿美元，本项目计划

投资总额为3亿美元，分两期实施：一期拟投资1亿美元；二期拟视一期项目孵化效果及市场发展需求，拟投资2亿美元。本项目全部达产后，预计年新增产能130万片高密度光电集成线路板，预计年新增营业收入20亿元人民币。

同意授权管理层或其授权代表，就本项目具体事宜（包括但不限于投资设立全资子公司）与常州市金坛区及金城镇人民政府进行磋商，代表公司签署投资合作协议及相关法律文件，办理子公司设立的工商注册、备案等相关手续，并授权管理层或其授权代表根据本项目实际推进情况、市场变化及政府政策要求，对投资金额、建设进度、产能规模等进行合理调整，以及处理本项目实施过程中的其他必要事项。

本项目全部达产后，预计年新增营业收入20亿元人民币，是基于目前情况的预估，不构成对投资者的实质性业绩承诺，如因有关政策调整、项目核准、市场环境、前沿技术开发等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。敬请投资者注意投资风险。

《关于同意签署投资合作协议暨对外投资设立全资子公司的公告》详见2026年1月13日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第八届董事会战略与ESG委员会会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日